

供媒體即時發佈

投資關係者：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係者：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 推出新款 Aleris™ 8330 薄膜量測機台

專為生產線提供穩定、低成本、高產出的薄膜厚度、折射率和應力的精準測量

【加州 MILPITAS 2010 年 8 月 4 日訊】今天，專為半導體和相關產業提供製程控制與良率管理解決方案的全球領先供應商 [KLA-Tencor Corporation](#) /美商科磊（納斯達克股票代碼：[KLAC](#)）今天推出的最新產品，讓 Aleris 系列薄膜量測機台又添一員生力軍。作為專為測量關鍵性薄膜而設計的現有 Aleris 8350 的互補，[Aleris 8330](#) 是穩定、極具生產價值和低購置成本的測量解決方案，能夠測量 32 奈米以及更小線寬世代的一般薄膜的厚度、折射率和應力。極具成本效益的 Aleris 8330 和高度靈敏的 Aleris 8350 組成了適用於各種薄膜層的綜合解決方案，有助於半導體製造廠在生產中篩檢製程問題，並保持較高良率。

KLA-Tencor 的薄膜與散射測量技術部 (FaST) 副總裁兼總經理 Ahmad Khan 表示：「許多半導體製造廠都已採用高性能與擴展性的 Aleris 系列量測機台，但同時希望針對一般性薄膜的生產監控採用較低成本效益的機台版本。Aleris 8330 可以為半導體製造廠在 Aleris 系列量測機台上提供了良好成本效益的方法，或讓已經採用 Aleris 系列量測機台的半導體製造廠將整廠薄膜測量能力更進一步擴展與最佳化。Aleris 8330 提供了比我們的前世代 ASET-F5x 量測機台更高的產能。此外，不同型號的 Aleris 系列量測機台之間的量測程式共用和降低機台量測差異化，有助於縮短生產整合時間，並提升半導體製造廠的營運效率。這些優勢對所有半導體製造廠都極具吸引力，特別是面臨市場挑戰的記憶體製造廠。」

Aleris 8330 包括專為成本效益的薄膜製程控制而設計的若干功能：

- 寬頻光譜橢圓偏光技術 (BBSE)、白光反射測量 (WLR) 和可選配的紫外線反射計 (UVR) 等光學技術已經獲得專利，旨在提供薄膜生產監控所需的精準性、穩定性和降低機台量測差異化
- 與 KLA-Tencor 的前世代薄膜度量工具相比，產能最高提升 1.85 倍，能夠提供低購置成本的薄膜製程控制
- 前世代平台 (ASET-F5x 和 SpectraFx™) 的量測程式匯入和遠端管理將各機台迅速整合，便利生產
- 不同 Aleris 系列量測機台之間的量測程式共享，有助於半導體製造廠展現靈活的製程控制策略，同時適用於高階和低階薄膜應用
- 可選配的 StressMapper 具備先進的應力測量功能，有助於半導體製造廠篩檢出會導致薄膜裂損或剝落、或造成疊對錯誤的製程問題
- 穩定可靠且可以擴展的架構能夠保障半導體製造廠的資本投資

Aleris 系列量測機台已向全球主要半導體廠商出貨，用於 2Xnm 開發和 4Xnm/3Xnm 生產。為了保持高性能和高產能，Aleris 系列量測機台由 [KLA-Tencor/美商科磊](#) 的全球綜合服務網提供支援。有關 Aleris 8330 薄膜度量工具的更多資訊，請查閱產品網頁：<http://www.kla-tencor.com/metrology/alerisfamily.html>。

*關鍵薄膜，例如超薄擴散層，通常有最小的線寬和最窄的製程變異容許度。在半導體生產製程中，由大多數薄膜層構成的一般薄膜具有更大的製程變異容許度，並且包括諸如金屬間電介質(inter-metal dielectrics)、光阻膜(photoresists)、防反射塗層(bottom anti-reflective coatings)、厚氧化矽(oxide)與氮化矽(nitride)以及後段層(back end of line layers)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor/ 美商科磊公司（納斯達克股票代碼：**KLAC**）是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、化合物半導體、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。**KLA-Tencor** 的總部設在美國加利福尼亞州 **Milpitas**，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。（**KLAC-P**）

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 **Aleris 8330** 的預期效能與預計成本、**Aleris 8330** 工具的使用者能夠實現的營運收益及其他獲利等聲明，均為前瞻性聲明，並受到《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(**Private Securities Litigation Reform Act of 1995**)規定的「安全港」條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題）或影響我們產品實現或使用的意外技術挑戰或限制，實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###